

INTERACTIVE SCIENCE COMMUNICATION

把看不見的半導體封裝，變成一個可以探索的空間。

以台積電 CoWoS-S 公開資料為研究基礎，透過旋轉、拆解、剖切與資料路徑，讓非專業觀眾也能理解先進封裝的尺度、位置與功能關係。



12 元件族群

6 導覽章節

4 工程視角

3 縮放層級

01 / DESIGN RESPONSE

從問題到互動系統

- 01 旋轉與底視
像 Google Earth 一樣建立空間理解。
- 02 拆解與剖面
直接辨識晶粒、中介層、基板與接點。
- 03 導覽與探索
45 秒快速理解，再自由追問 12 類元件。

02 / RESEARCH METHOD

精準，也誠實標示未知

公開資料決定架構；教學目的決定視覺尺度；互動設計決定觀眾如何理解。模型不對應台積電官方 CAD 或任何客戶產品 floorplan。

PUBLIC EVIDENCE

CoWoS-S 架構、矽中介層、TSV 與 HBM 功能關係

03 / ITERATION

01 平面圖鑑 → 02 3D 空間 → 03 工程重建 → 04 可論證敘事

OPEN THE INTERACTIVE WORK

開啟作品，親自旋轉一枚 AI 封裝

<https://xijing-silicon-atlas.pages.dev/>

資料來源：TSMC CoWoS / TSV Interposer Research / 2020 Large-scale CoWoS Platform